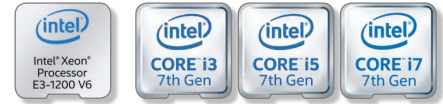


GAP-351F - Serie G6 WORKSTATION RUGGED 3U



Intel® Xeon® E3-1200 v5/v6, Intel® 6^a/7^a Gen. Core™ serie i7/i5/i3 - Kaby Lake / Sky Lake
I/O Motherboard Frontali e Alimentatore Posteriore



3U

Piattaforma



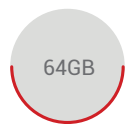
510 mm

Profondità



1-2

CPU



64GB

RAM



3+3

SSD



5

Schede I/O

GAP è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

Le workstation rugged GAP-351F G6 integrano un singolo processore Intel® Xeon® E3-1200 v5/v6, Intel® 6th/7th Gen. Core™ i7/i5/i3 (KabyLake / Skylake) che offre fino a 4 Core (8 Core logici grazie alla tecnologia Hyper-Threading), 8MB di Smart Cache, supporto per memorie DDR4 con o senza ECC, fino a 64GB e 16 lane PCIe 3.0.

I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità. GAP-351F è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 3U di altezza e 510mm di profondità. La configurazione con I/O motherboard frontali e alimentatore posteriore consente di disporre di tutte le porte della motherboard e delle schede integrate sul fronte dell'apparato. Le workstation rugged GAP-351F possono ospitare tre SSD estraibili, tre SSD interni e un DVD Slim. All'interno possono essere integrate fino a cinque schede PCIe. Le schede aggiuntive sono provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

Le workstation rugged GAP sono qualificate MIL-STD-810G per temperatura e shock, MIL-STD-167-1A per vibrazioni e possono avere conformità opzionale alla MIL-STD-461. Su richiesta gli apparati integrati, completi di schede di I/O, possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati, completi di schede di I/O, possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

CARATTERISTICHE

- Workstation Rugged 3U - 510mm profondità
- Singolo processore
- Intel® Xeon® serie E3-1200 v6/v5
- Intel® 7^a/6^a Gen. Core™ serie i3
- I/O motherboard frontali
- Ingresso di alimentazione posteriore
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- Fino a 3 SSD Hot Swap + 3 SSD interni
- DVD opzionale
- Fino a 5 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Intel® Xeon® E3-1200 v5/v6, Intel® 6 ^a /7 ^a Gen. Core™ i7/i5/i3, Intel® Celeron® e Intel® Pentium®
Memoria	Fino a 64GB ECC/non-ECC UDIMM, DDR4-2400MHz
Chipset	Intel® C236
Porte rete	1 x GbE LAN con Intel® i210-AT 1 x GbE LAN con Intel® I219lm
Storage	6 porte SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
TPM	1 TPM Header
I/O motherboard	Disponibili sul fronte: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x LAN, 1 x HDMI, 1 x DVI, Audio
Schede aggiuntive	3 PCI-E 3.0 x16 (esecuzione a 16/NA/16 o 16/8/8), 1 PCI-E 3.0 x1 (in x4) 1 slot 5V PCI 32-bit Interfaccia M.2: 1 PCI-E 3.0 x4 Formato: 2242/2260/2280 - Key: M-Key
Sistemi operativi	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016, Linux
IPMI	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
Monitoraggio remoto	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID).

Alimentazione

Alimentatore	100/240 VAC Ridonato 18-36 VDC Singolo o Ridonato 36-72 VDC Singolo o Ridonato
---------------------	--

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	483 x 133 x 510 mm
Materiale	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
Colore	Silver
Alloggiamento	Chassis 3U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
Configurazione	I/O motherboard frontali e alimentatore posteriore
Pannello frontale	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset
Baie Drive	1 x 5.25" slim; 1 x baia 3.5" + 1 x baia interna x 3 ODD 2.5"

Parametri Ambientali - (Design to meet)

Temperatura operativa	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
Umidità operativa	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
Temperatura storage	-40°C / +70°C
Vibrazioni	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
Shock operativo	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms - half sine
Shock trasporto	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
Certificazioni	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.